

低温固化导电胶 ECA30

产品概述

Low Temp cured Electronic Conductive Adhesive

ECA30 是一款低温固化单组份环氧导电银胶，适用于高速施胶工艺，要求低温工艺固化后产品具有高导电、导热特性和高可靠性等特点。典型应用包括半导体封装的晶片贴装，LED 芯片的固晶粘接，以及其他需要导电粘接的场合。

注意：使用前须先将针筒垂直放置以达到室温，切勿重复冻结。

固化前产品特性

外观	银灰色粘稠液体
粘度 (Brookfield CP52, mPa.s(cP))	20000
密度 (ASTM D792, g/cm ³)	3.5
触变指数 (1/10rpm)	8.9
常温使用寿命 (小时)	24
存储寿命 (-40°C, 天)	365

产品固化条件

175°C	2min
替代固化条件	150°C 3min
	120°C 10min
	80°C 1hour

固化后产品特性

项目	测试方法	单位	数值
玻璃化温度 (T _g)	TMA	°C	112
热膨胀系数 T _g 以下	TMA	ppm/°C	54
热膨胀系数 T _g 以上	TMA	ppm/°C	162
导热系数	Laser Flash	W/mK	1
体积电阻	--	Ohm/cm	<=0.0002
热失重	TGA @300°C	%	0.35
饱和吸水率	85 °C/85RH	%	0.6
剪切强度	2*2mm Si die on Ag/Cu LF	Kg (25°C)	>=3.5
剪切强度	2*2mm Si die on Ag/Cu LF	Kg (150°C)	>=2.8
剥离强度	--	N/mm ²	7.0
操作温度, °C	--	--	-50-200

产品包装及货期

包装	17.5g、35g 针管
最小包装量 (MPQ)	5CC
最小订单量 (MOQ)	5CC
交货期 (L/T)	10-20 个工作日